DAEDUCK

대덕전자 ㈜
2021년 1분기 경영실적

2021.05

Disclaimer

본 자료는 투자자의 투자판단을 위한 참고자료로 작성 된 자료 입니다.
당사는 20년 5월 1일을 기준으로 회사가 분할 되어 신규설립 됨에 따라,
공시기준으로는 20년 5월 이후에 해당하는 실적 부터 확인됩니다.
그러나, 사업회사의 경영은 지속되고 있음을 감안하여, 기존 투자자들의 편의를 도모 코져,
실적 사항은 분할 전 실적을 포함한 사업 연속성 기준으로 작성 되었습니다

또한, 내용에서 언급하는 미래에 대한 예측 정보는 투자자 편의를 위한 참고사항으로,
향후 경영환경과 시장의 변화에 따라 차이가 발생할 수 있음을 양해 바랍니다.

당사는 본 자료의 내용에 있어 투자자에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.
또한 당사는 투자자 여러분의 독립적인 판단에 의하여 투자가 이루어 질 것으로 신뢰 합니다.

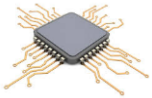
본 자료의 재무자료는 K-IFRS 별도기준 입니다.

회사개요 및 사업소개

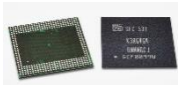
[회사개요]

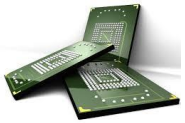
회사명	대덕전자 ㈜
대표	신영환
설립일	2020년 5월 1일 (회사분할) ※최초설립 : 1972년 8월
신규상장일	2020년 5월 21일
자산규모	8,265억 (2021.03)
임직원수	2,410명 (2021.03)
본사위치	경기도 안산시 단원구 강촌로 230
해외거점	대덕 베트남

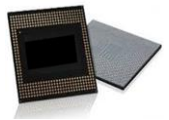
[사업소개]



BGA / Flip Chip


DRAM


Nand


AI, Controller, AP

· 메모리 및 비메모리 用 반도체 Package 기판

Module SiP

Camera Module

Finger Printing Sensor

Wearable

· Mobile, SiP (Wearable, AiP 등) 用 기판

MLB

Repeater (5G)

Probe Card

Automotive

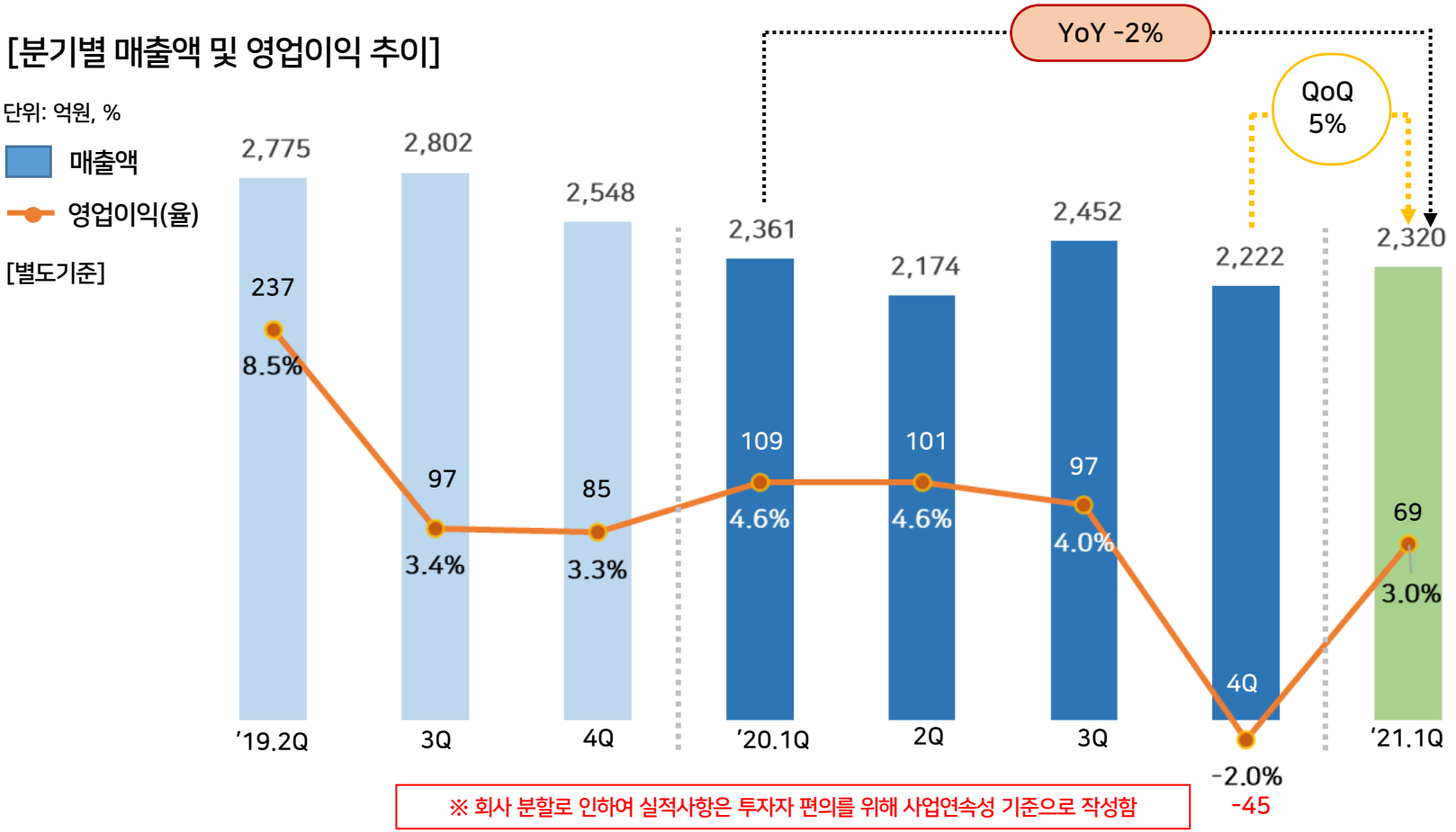
· 5G Network 장비 및 반도체 Tester 등 MLB 기판

'21년 1분기 실적

· 매출 : 반도체 패키지 向 Substrate 에 대한 수주 강세 지속. 환율하락 불구, 전기대비 5% 증가한 2,320억 기록.
카메라 모듈용 PCB 수주는 상대적으로 양호했으나, 2분기 부터 감소전망에 따라, 지문인식 센서,
웨어러블 용 PCB양산 등을 통한 수주 감소 상쇄 추진.

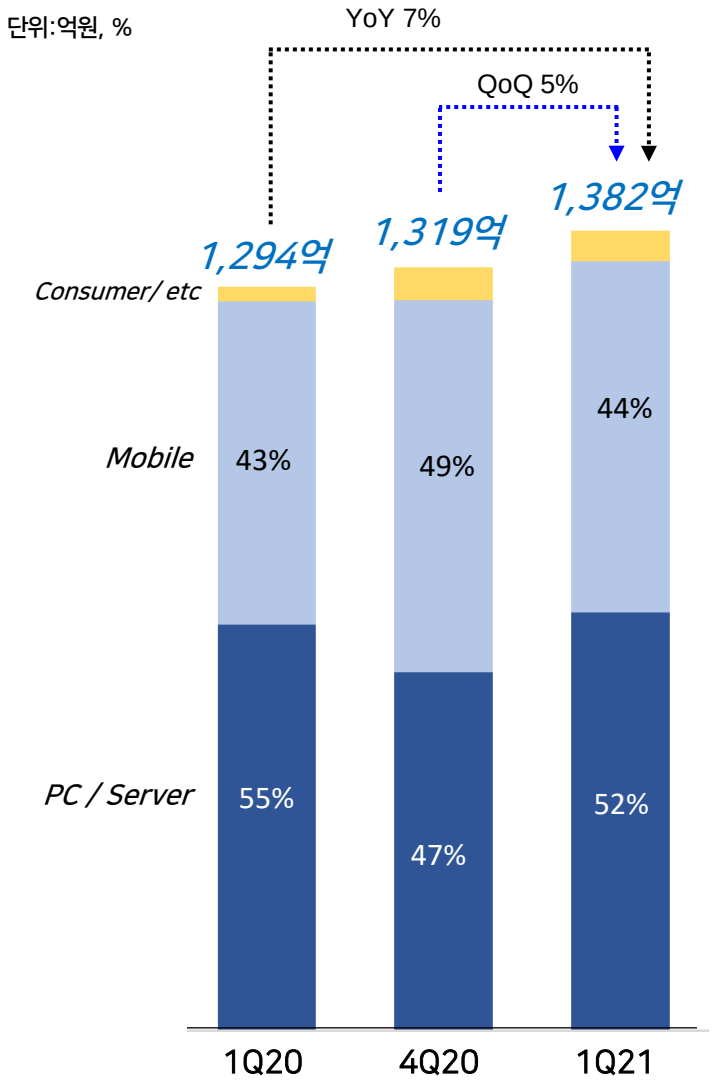
· 손익 : 흑자전환. 그러나 환율하락, 원자재가 상승, FCBGA 신공장 SET-UP에 따른 상각비 부담 등으로,
이익 규모는 69억에 그침. 향후 일부 제품가 현실화 및 신제품 대응을 통해 손익 개선에 주력.

[분기별 매출액 및 영업이익 추이]



※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

BGA/FC Div. '21년 1Q 실적 및 2Q 예상



•'21년 1분기 실적

전 제품 실적호조에 따른 수익성 제고

- PC/Server向 메모리 수요 증가 (DDR, LPDDR)
- Mobile 및 Consumer 向 비메모리 물량확대
- 글로벌 고객 증가에 따른 FCBGA 추가투자 단행

•2분기 예상

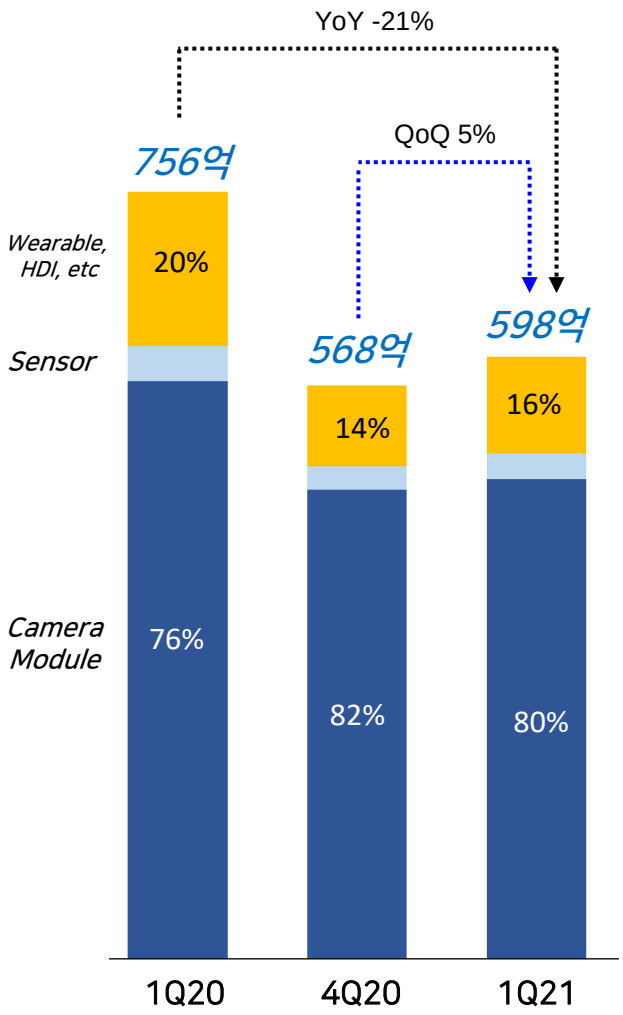
반도체 시장환경을 바탕으로 지속 성장 전망

- 반도체 공급부족 배경으로 글로벌 수주 물량 지속 증가
- 시장 수급에 따른 가격 현실화 진행
- FCBGA 신공장 가동준비 완료, 양산 승인절차 진행

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

Module SiP Div. '21년 1Q 실적 및 2Q 예상

단위:억원, %



•'21년 1분기 실적

공정효율화 및 신규물량에 따른 수익 개선

- 고객사 신규모델 출시에 따른 ASP 개선 및 물량증가 (High-End급 고사양 모델 증가)
- 공정 운영 효율화를 통한 비용절감

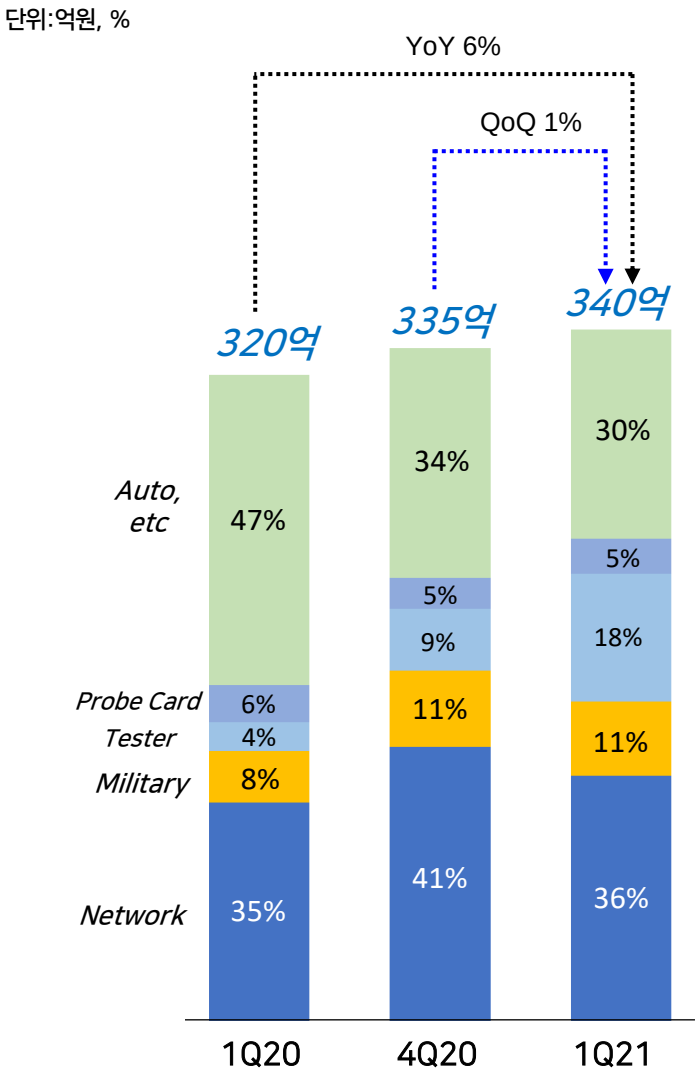
•2분기 예상

시장변동 대비, 포트폴리오 확대 개선 강화

- 신제품 공백 및 부품수급 불균형으로 글로벌 시장 위축 우려
- 지문인식센서 등 양산 확대
- 웨어러블, AIP 등 신규시장 확대 주력

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

MLB Div. '21년 1Q 실적 및 2Q 예상



•'21년 1분기 실적

사업성 확보를 위한 다각적 개선 진행

- 수익성 확보를 위한 제품 Mix 개선 진행
- 반도체 시장 호조에 따른 관련 물량 급증
  (공정장비 및 Probe Card)

•2분기 예상

제품 Mix 조정을 통한 사업성 개선 주력

- 글로벌 네트워크 및 방위산업 물량 확대
- 신규시장 진입을 위한 제품 승인 및 납품 예정 (위성네트워크)
- 반도체 관련 장비 등 지속확대 전망

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

요약재무제표 (별도기준)

[재무상태표]

단위:억원

구분	2020.12	2021.03
□ 자산총계	7,974억	8,265억
유동자산	2,526억	2,745억
현금 등	204억	136억
금융상품	2억	2억
채권 등	1,362억	1,578억
비유동자산	5,448억	5,520억
□ 부채총계	1,547억	1,856억
유동부채	1,447억	1,730억
비유동부채	100억	126억
부채비율	24.1%	29.0%
□ 자본총계	6,427억	6,409억
자본금	257억	257억

[손익계산서]

단위:억원

구분	2020.12	2021.03
매출액	6,144억	2,320억
BGA/FC	3,634억	1,382억
Module SiP	1,632억	598억
MLB	878억	340억
영업이익	119억	69억
%	1.9%	3.0%
세전이익	-120억	103억
당기순이익	-115억	137억
%	-1.9%	5.9%
EBITDA	626억	282억
%	10.2%	12.2%

※ 2020년 실적은 인적분할에 의해, 20년 5월 이후 8개월 분만 표기됩니다.

ESG 주요현황

당사 ESG 평가등급은 2020년 기준 **종합 'A' 등급** 으로 우수한 지속가능 경영체제를 구축하고 있습니다.

Environmental

환경경영인증	환경 경영 조직	환경 정보 공개	환경 교육
ISO14001 보유	실무 조직 보유	환경정보공개시스템 공개 홈페이지 공개	임직원 대상 환경교육 실시

Social

사회공헌	공정거래	협력사 지원	인권보호
사회공헌프로그램 **운영**	공정거래 실천 프로그램 **운영**	협력사 지원프로그램 **운영**	인권침해 예방 프로그램 **운영** 인권영향평가 **실시**

Governance

이사회 운영실적	배당	감사기구	ESG 등급공개
직전 1년간 16회 개최	1주당 300원 현금 배당성향 31%	상근감사 선임	전체 4개(E/S/G/ESG) 등급 중 4개 등급을 투자자에게 공개

※ ESG등급은 KCGS (한국기업지배구조원) 평가결과에 근거합니다

- 감사합니다 -